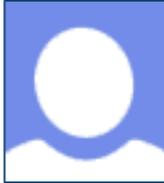


11月1日(金) 15:15-17:30

セッションチェアマン： 不破 保博(元ローム株)・藤原 健典(東レ株)

◆ Si 貫通電極ウェーハ全自動研削装置について(仮題)



電子株式会社岡本工作機械製作所  
技術開発本部  
ナノプロセス技術部 要素プロセス開発課  
課長  
三井 貴彦

[講演要旨]

[講演者プロフィール]

◆ LIDE-Advanced Packaging-Wafer/Panel-Level Packaging

分野におけるガラス材料の可能性



LPKE Laser & Electronics 株式会社  
セールスダイレクター  
上館 寛之

[講演要旨]

次世代半導体パッケージや高速通信の分野でガラス基板への期待が高まっている。ガラスは電氣的・機械的・化学的な特性に優れているが、微細加工が難しい状況が続いてきた。ガラスへの貫通孔加工 (TGV) や微細構造を高速、高精度、歩留まりよく加工できる、独 LPKF 社が開発した特許技術 LIDE (Laser Induced Deep Etching) を紹介する。

[講演者プロフィール]

20年以上ドイツ LPKF 製品販売に携わる。レーザーデパネリング、レーザードリル、3D-MID (LDS)、レーザー溶着、ガラス微細加工 (LIDE)、プリント基板加工機などの販売、サポートを担当。

◆ 半導体パッケージ向け材料の動向



東レエンジニアリング株式会社  
営業部 営業技術 T  
主任部員  
河村 知範

[講演要旨]

[講演者プロフィール]

---

※本講演に興味を持たれた方は、こちらの講演もご覧になっています。

【D-1】最新のパッケージ・実装技術動向

【D-2】光通信デバイス